

一、資本市場動態

1. IPO 初次上市櫃

(1) 上市櫃送件審查概況

申請 類型	公司 代號	公司 簡稱	申請 日期	董事長	申請時 股本 (仟元)	審議委員會 審議日期	董事會通過上 市櫃日期	主管機關核准 (備查)上市櫃 契約日期	備註
上市	7874	禾碩康-KY	115.04.29	康潤生	270,000	115.07.31	115.08.25	115.09.04	-
上市	7710	東擎科技	115.06.05	李俊瑩	639,053	115.07.16	115.08.25	-	-
上市	6959	兆捷科技	115.07.16	高啓全	391,674	115.08.26	-	-	創新板
上市	8058	耐特	115.07.20	陳勳森	688,000	115.08.28	-	-	-
上市	7843	英柏得	115.07.24	林傳生	334,400	115.09.02	-	-	科技事業
上市	7883	饗賓	115.07.27	陳毅航	609,760	115.09.04	-	-	-
上市	7901	大大寬頻	115.08.27	張銘志	600,000	-	-	-	-
上市	8345	超秦	115.09.02	卓靖倫	600,080	-	-	-	-
上市	7729	仲恩生醫	115.09.02	王玲美	806,822	-	-	-	科技事業
上櫃	7848	騏億鑫	115.05.12	洪國庭	298,000	115.07.29	115.08.21	115.08.26	-
上櫃	6938	藍新資訊	115.06.09	郭延群	125,700	115.08.03	115.08.21	115.08.26	-
上櫃	6825	和暢科技	115.06.17	周邦基	336,514	115.07.29	115.08.21	115.08.26	-
上櫃	3595	山太士	115.06.17	吳學宗	339,133	115.07.31	115.08.21	115.08.26	-
上櫃	4565	宏偉	115.06.26	黃燦城	617,400	115.08.11	115.08.21	115.08.26	-
上櫃	7869	宏于電機	115.06.26	詹家榮	272,410	115.08.06	115.08.21	115.08.26	-
上櫃	7762	吉晟生	115.08.24	楊朝堂	580,913	-	-	-	-
上櫃	7789	開展	115.08.31	邱泰翰	211,836	-	-	-	-

(2) IPO 承銷概況：本期無新增

2. SPO(國內外籌資)

(1) 籌資案送件審查概況

證券代號	公司型態	公司名稱	案件類別	金額(仟元)	發行價格(元)	收文日期	自動補正日期	停止生效日期	解除生效日期	生效日期
8422	上市	可寧衛*	轉換公司債 (無擔保)	2,500,000		115.07.17	115.08.03 115.08.10 115.08.25			115.09.10
2357	上市	華碩電腦	轉換公司債 (海外無擔保)	1,500,000 (美元)		115.08.20				115.09.07
2316	上市	楠梓電子	轉換公司債 (無擔保)	3,500,000		115.08.24				115.09.21
6834	上市	天二科技	現金增資	100,000	80.00	115.08.25				115.09.10
4958	上市	F-臻鼎 (福邦主辦)	轉換公司債 (海外無擔保)	800,000 (美元)		115.08.27				115.09.14
4938	上市	和碩聯合	轉換公司債 (海外無擔保)	500,000 (美元)		115.08.28				115.09.15
8996	上市	高力 熱處理	轉換公司債 (無擔保)	2,500,000		115.08.31				115.09.16
8996	上市	高力 熱處理	轉換公司債 (無擔保)	1,500,000		115.08.31				115.09.16
1727	上市	中華化工	轉換公司債 (無擔保)	1,000,000		115.09.01				115.09.17
1727	上市	中華化工	現金增資	138,000	72.00	115.09.01				115.09.17
2025	上市	千興 不銹鋼	現金增資	400,000	10.00	115.09.02				115.10.02
6534	上市	正瀚生技-創	轉換公司債 (有擔保)	700,000		115.09.02				115.09.18
6285	上市	啓碁科技	轉換公司債 (無擔保)	6,000,000		115.09.03				115.09.21
6285	上市	啓碁科技	轉換公司債 (無擔保)	2,000,000		115.09.03				115.09.21
5475	上櫃	德宏工業	現金增資	120,000	91.60	115.08.03	115.08.28			115.09.29
6129	上櫃	普誠科技 (福邦主辦)	現金增資	200,000	15.00	115.08.07	115.08.20			115.09.17
8038	上櫃	長園科技	現金增資	80,000	30.00	115.08.10				115.09.07

證券代號	公司型態	公司名稱	案件類別	金額(仟元)	發行價格(元)	收文日期	自動補正日期	停止生效日期	解除生效日期	生效日期
6488	上櫃	環球晶圓	存託憑證(海外)	1,500,000(美元)		115.08.19	115.09.02			115.09.18
2756	上櫃	聯發國際	轉換公司債(無擔保)	400,000		115.08.20				115.09.07
3289	上櫃	宜特科技	轉換公司債(無擔保)	1,200,000		115.08.24				115.09.09
6174	上櫃	安碁科技	轉換公司債(無擔保)	300,000		115.08.24				115.09.09
3691	上櫃	碩禾電子材料	現金增資	100,000	100.00	115.08.26				115.09.23

(2) SPO 掛牌概況

A. 現金增資

掛牌日期	證券代碼	發行公司	發行價格(元)	折溢價率	募集金額(仟元)	承銷方式	資金用途	中籤率(%)
115.08.18	1295	生合	45.00	89.82%	140,625	公開申購	償還銀行借款	6.15
115.08.18	6569	醫揚	88.00	79.04%	330,000	公開申購	償還銀行借款 充實營運資金	1.02
115.08.21	5263	智崴	85.80	85.39%	429,000	公開申購	償還銀行借款 充實營運資金	1.87
115.08.21	6492	生華科	34.00	78.07%	850,000	公開申購	充實營運資金	8.43
115.08.28	8054	安國 (福邦主辦)	77.00	79.79%	192,500	公開申購	償還銀行借款 充實營運資金	1.10

B. 可轉換公司債

掛牌日期	債券代碼	發行公司	發行總面額(億)	每張發行價格	發行年限(年)	有無擔保	轉換溢價率	轉換價格(元)	賣回/到期年收益率(%)					承銷方式	資金用途
									1年	2年	3年	4年	5年		
115.08.17	55363	聖暉	15	117.04	3	無	104.80%	1,158.00	-	0.00%	0.00%			競拍	充實營運資金
115.08.17	89365	國統	6	110.35	3	有	103.58%	55.00	-	0.50%	0.00%			競拍	償還銀行借款 充實營運資金
115.08.18	30166	嘉晶	3.5	101.00	3	無	107.56%	105.00	-	-	0.00%			詢圈	購置機器設備 及相關廠務工程
115.08.18	35122	皇龍	6	102.75	3	有	104.86%	20.50	-	0.00%	0.00%			競拍	償還銀行借款 充實營運資金 (營建工程)
115.08.18	49675	十銓	30	124.55	5	無	101.67%	213.50	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	競拍	償還銀行借款 充實營運資金
115.08.21	49731	廣穎電通	5	100.00	3	無	106.67%	169.60	-	-	0.00%			詢圈	償還銀行借款
115.08.25	32191	倚強科	6	109.50	3	無	160.58%	66.40	-	1.00%	0.00%			競拍	償還銀行借款 充實營運資金
115.08.26	76311	聚賢研發-創	4	100.50	3	無	105.38%	150.80	-	0.25%	0.00%			詢圈	償還銀行借款 轉投資美國子公司 充實營運資金
115.08.28	89366	國統	6	102.00	3	無	102.09%	53.80		0.50%	0.00%			競拍	償還銀行借款 充實營運資金
115.08.31	31494	正達	6.5	113.79	3	有	104.42%	68.10	-	-	0.00%			競拍	購置機器設備 償還銀行借款 充實營運資金
115.09.03	15602	中砂	10	124.21	3	無	102.00%	708.30	-	-	0.00%			競拍	充實營運資金
115.09.03	23032	聯華電	40	119.82	5	無	104.98%	130.70	-	-	0.00%	-	0.00%	競拍	購置機器設備 及廠務工程

3. 財務顧問案件

(1) 公開收購

董事會 決議日	公開收購人		被收購公司		最高收購 股份/比率	最低收購 股份/比率	每股收購 價格	收購總價金
	代號	名稱	代號	名稱				
115.08012	NA	台信電訊	6214	精誠	157,901 千股 /58.00%	106,175 千股 /39.00%	92.50 元	146.05 億元
115.08.17	NA	胡正杰	6806	森崴能源	200,000 千股 /72.82%	140,000 千股 /50.98%	0.05 元	0.1 億元

(2) 股份轉換

董事會 決議日	股份轉換 類型	收購方公司 (A)			被轉換公司 (B)			換股比例 (A:B)	股份轉換 基準日
		代號	名稱	資本額(億)	代號	名稱	資本額(億)		
115.09.01	簡易型	2884	玉山金	1,772	A00008	玉山投信	30	現金收購 每股 168 元	116.01.04

(3) 分割

董事會 決議日	代號	被分割公司	受讓公司	分割營業價值	換股比例	分割基準日	備註(說明)
115.08.31	8472	納維康	100%子公司 蕾綿國際	0.11 億元	以現金為對價	115.11.01	非對稱分割

(4) 股份交換、合併之市況：本期無新增。

二、福邦主辦案件快訊

(一) IPO

申請 類型	公司 代號	公司 簡稱	申請 日期	董事長	申請時 股本 (仟元)	審議委員會 審議日期	董事會通過 上市櫃日期	主管機關核准 (備查)上市櫃 契約日期	備註
上市	7867	特力屋	115.04.29	何湯雄	960,000	115.06.09	115.07.21	115.07.30	

(二) SPO

證券代號	公司型態	公司名稱	案件類別	金額(仟元)	發行價格(元)	收文日期	生效日期
6597	上櫃	立誠光電	轉換公司債 (無擔保)	450,000		115.07.27	115.08.12
2317	上市	鴻海精密	轉換公司債 (海外無擔保)	1,500,000 (美元)		115.07.30	115.08.17
8021	上市	尖點科技	轉換公司債 (無擔保)	480,000		115.08.19	115.09.04
8021	上市	尖點科技	現金增資	40,000	300.00	115.08.19	115.09.04

三、近期公告法規修正

類別	公告機構	函號	公告訊息
上市公司	臺灣證券交易所	臺證交字第 11500166241 號	公告修正本公司「上市股票零股交易辦法」第三條、第八條及第八條之一條文，自 115 年 12 月 7 日起實施。
上櫃公司	證券櫃檯 買賣中心	證櫃交字第 11500704631 號	修正本中心「零股交易辦法」第 4 條、第 7 條及第 8 條條文，自 115 年 12 月 7 日起實施。
興櫃公司	證券櫃檯 買賣中心	證櫃交字第 11500710961 號	公告本中心「興櫃股票推薦證券商內部作業辦法應行記載事項要點」第 3 點等 2 項修正條文，自 116 年 2 月 22 日起施行。
現金增資案件 - 上市(櫃)公司及 第一上市(櫃)公司	證券商業同業公會	中證商業五字第 1150004527 號	公告修正本公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」等 6 項規章，自公告日(8/18)起施行。

四、近期焦點新聞

1. IPO 焦點新聞

新聞重點	來源	日期
通吃 CPO 與 AI 無人載具紅利！和亞智慧預計 9 月中掛牌上櫃	財經新報	115.08.18
搶攻中階企業 AI 儲存缺口！廣盛科技 8/20 以每股 268 元登錄興櫃	科技新報	115.08.18
電力交易服務延伸日澳！泓德小金雞星星電力預計第四季登錄興櫃	財經新報	115.08.25
《電週邊》宜鼎三廠年底動工拚 2028 完工 旗下安提啟動 IPO 計畫	富聯網	115.08.27
耐特將上市 拓展雙應用	經濟日報	115.08.31

2. SPO 焦點新聞

新聞重點	來源	日期
致茂股東會擬討論現增 GDR 法人估籌資上看 267 億元	經濟日報	115.08.26
聯電發 18 億美元海外轉換公司債買設備及廠務工程	中央通訊社	115.08.26
盟立現增募資約 11.73 億元，擴充先進封裝及 AI 自動化產能	MoneyDJ	115.08.27
安成生技(6610)4.5 億元現增到位！核心新藥 AC-203 迎關鍵里程碑	東森財經新聞	115.08.28
聯發科完成 39 億美元海外可轉債訂價 輝達、Alphabet 都出手認購	經濟日報	115.08.31

3. 財顧焦點新聞

新聞重點	來源	日期
Grab 擬併 foodpanda 外送團體反對	中國時報	115.08.19
財經七案 下會期再戰	經濟日報	115.08.25
台灣連鎖餐飲含金量高 外資狩獵目標	LTN 經濟通	115.08.31
鴻海、英飛凌點出台股投資歐盟新機會：從封裝一路攻 AI 資料中心	經濟日報	115.09.01

4. 總體經濟及重要產業概況

新聞重點	來源	日期
AI 需求強勁！第 2 季製造業產值逾 6.8 兆元、年增 27.1% 連 10 季正成長	經濟日報	115.08.19
畢業生尋職！7 月失業率升至 3.39%、仍創 26 年同月最低	自由財經	115.08.24
伺服器記憶體出口暢旺！7 月批發業營業額 1.75 兆元 年增 56.4%雙創高	經濟日報	115.08.25
加強與台 AI 鏈合作！傳晶片材料廠味之素、大金 擴大台灣營運	經濟日報	115.09.01

五、福邦承銷部專業服務團隊

組別	職稱	各組主管	聯絡方式
部門主管	副總經理	藍順得	02-2383-6808
			alexlan@mail.gfortune.com.tw
輔導組	業務副總經理	李莉綾	02-2383-6825
			leelylee@mail.gfortune.com.tw
	業務副總經理	徐斌惟	02-2383-6835
			wolfganthsu@mail.gfortune.com.tw
	業務協理	李昆諺	02-2383-6812
			lancelee@mail.gfortune.com.tw
	業務協理	許逸驥	02-2383-6834
			perryhsu@mail.gfortune.com.tw
	業務資深協理	吳孟穎	02-2383-6836
			mengyingwu@mail.gfortune.com.tw
財務顧問組	業務協理	黃虹禎	02-2383-6839
			hungchen@mail.gfortune.com.tw
	業務資深協理	蔡易錢	03-657-2758(新竹)
			mosstsai@mail.gfortune.com.tw
	業務資深協理	謝灼梅	06-222-6156(台南)
			mayhsieh@mail.gfortune.com.tw
	業務資深協理	周子程	06-222-6156(高雄)
			stevenchou@mail.gfortune.com.tw
業務組	業務協理	黃鳳丹	02-2383-6840
			wendyhuang@mail.gfortune.com.tw
	業務資深協理	連偉琦	02-2383-6850(北區)
			vickylan@mail.gfortune.com.tw
	業務資深協理	王建中	06-222-6156(南區)
			josephwang@mail.gfortune.com.tw

通吃 CPO 與 AI 無人載具紅利！和亞智慧預計 9 月中掛牌上櫃 財經新報 115.08.18

和亞智慧明日將舉辦上櫃前業績發表會，預計 9 月中掛牌交易，董事長石文機表示，第二季營運虧損，主要是受到終端客戶資本支出轉趨保守與設備驗收遞延影響，但下半年將積極透過半導體檢測與無人載具兩大塊彌補光學模組的營收缺口，預期隨產能與技術到位，明年將迎來多重收割期。

石文機表示，和亞智慧成立自 2015 年，核心團隊在光學、影像及自動化領域累積 20 年經驗，技術發展從 Camera Module 檢測、3D Sensing 逐步跨入 AR 光學精密對位、AI 瑕疵辨識、晶圓 AOI 及智慧製造系統，並在 2021 年獲台亞半導體策略投資，進一步將光學與影像導入半導體領域。

石文機指出，和亞智慧一方面推升高階晶圓、先進封裝及智慧製造投資，一方面發展無人機、機器人與各式無人載具，帶以軟體與演算法為技術核心，聚焦半導體、光學及無人載具三大產業，由傳統「讓機器看得見」，進一步朝「看得懂、即時決策」的 AI 智慧視覺與製造平台發展。

石文機分享，受到終端客戶資本支出轉趨保守與設備驗收遞延影響，和亞智慧第二季營運面臨虧損挑戰，但對未來展望保持穩健，強調客戶需求僅是遞延，並未消失，下半年將積極透過半導體檢測與無人載具兩大業務板塊彌補光學模組的營收缺口。

石文機說明，為降低單一產業波動風險，內部已啟動 BU（事業群）化重組，並將業務明確劃分出光學、半導體與無人載具三大主線，下半年有望藉由半導體與無人載具的穩健出貨，平衡光學領域帶來的營運衝擊，而半導體業務占 AOI（自動光學檢測）營收達 80%，展現強勁的轉型成效。

和亞智慧總經理陳志忠表示，和亞智慧真正的核心不是設備本身，而是設備背後的軟體、演算法與製程 Know-how，設備是技術落地的載體，希望建立的是可以跨產品、跨產業持續複製的技術平台，目前已形成「一個核心、三大產業、五大方案平台」的技術架構。

陳志忠指出，和亞智慧以 AI 影像、3D 視覺、精密定位、多模態感知、邊緣運算及 AI Agent 等軟體演算法為核心，向外發展 AI Platform、AA 精密對位、AOI 智慧檢測、Smart Manufacturing 及 Optical Module 五大方案平台，並將能力落地至半導體、光學與無人載具市場。

半導體領域方面，陳志忠指出，AI、HPC 需求持續推進高階晶圓、先進封裝、矽光子與 CPO 發展，製程愈複雜，對高精度檢測、精密光學對位與良率管理的要求也同步提升，讓 AI 不只判斷良品與不良品，更協助工程師理解問題來源及提升良率。

陳志忠說明，和亞目前已布局晶圓、晶片高階 AOI、2D 與 3D 檢測、AI 瑕疵分類、精密光學對位及 CPO、光電模組檢測等方案，希望將檢測能力由傳統 Defect Detection（找到缺陷），逐步推進至 Defect Classification（辨識缺陷），最終結合製程數據走向 Process Intelligence。

陳志忠認為，新一波 AI 機會來自實體 AI 與無人載具，隨著無人機、機器人及無人車加速導入自主導航、避障及環境辨識功能，視覺系統正從單一 Camera 升級為多感測融合與 AI 即時決策的重要核心。

陳志忠分享，和亞將過去累積的 RGB、3D、AR 及 LWIR 等光學技術，整合 AI 影像辨識、雙光與三光視覺、低延遲 Edge AI 運算，發展適用於無人機、機器人及各類無人載具的智慧視覺系統，而定位也從單純提供光學模組，逐步升級至光學模組、AI 邊緣運算、系統整合的完整解決方案。

陳志忠強調，和亞的商業模式由單一設備延伸至軟體、智慧檢測設備方案、代工與代測及系統整合四種業務型態，其中智慧製造提供全自動化產線與 MES 整合、AI 設備助理及智慧製造系統，而光學與無人載具則可提供雙光與三光視覺系統整合，至於半導體則涵蓋 AOI、精密光學檢測及相關代測服務，降低單純設備價格競爭。

展望未來 3~5 年，陳志忠指出，和亞將持續以軟體、檢測方案、光學模組與系統整合四大成長引擎，深化半導體高階檢測與精密光學技術，同時掌握無人機、機器人及 AI 智慧製造帶來的新需求，期望把 AI、光學、演算法及系統整合能力變成一個成長平台，讓機器從看得見、看得懂。



搶攻中階企業 AI 儲存缺口！廣盛科技 8/20 以每股 268 元登錄興櫃 科技新報 115.08.18

看準企業地端 AI (On-premise AI) 基礎架構的強勁需求，廣盛科技預計 8 月 20 日以每股參考價 268 元正式登錄興櫃，董事長陳志鵬指出，下一階段將把 XInsight 的預測性維運與 KSM 容器平台整合為中小企業也負擔得起的地端 AI 基礎架構平台，讓企業導入 AI 的門檻大幅降低。

陳志鵬表示，廣盛深耕企業級儲存領域逾 20 年，目前已成功從傳統儲存設備供應商，轉型為企業級地端 AI 基礎架構解決方案的提供者，以 2025 年營收結構來看，企業級儲存設備與配件貢獻 3.46 億元，占比 90.04% 為絕對主力，技術與增值服務 993 萬元，占 2.58%，其餘為商品轉售。

陳志鵬指出，廣盛與策略夥伴華碩 (ASUS) 與宏碁 (Acer) 兩大台灣科技集團，透過提供涵蓋 AI 資料儲存、資料保護、容器化平台及邊緣 AI 運算的完整解決方案，滿足不同規模的企業 AI 應用需求，增強廣盛在企業加速採納地端 AI 之際，同時將觸角延伸至全球市場。

陳志鵬分享，廣盛是台灣少數兼具硬體、韌體及軟體自主研發能力業者，產品涵蓋 NVMe 全快閃儲存陣列、統一儲存系統、SAN 與 NAS 設備，並自主開發 QSM、XEVO 與 XInsight 等軟體平台，更進一步推出 KSM 整合式容器平台及 QSeal、QScale、QMetro、XVault 等企業級軟體方案。

陳志鵬說明，廣盛不投入超大型資料中心的軍備競賽，而是聚焦中大型企業與關鍵任務市場，以企業級功能搭配成本效益的差異化優勢，先在印度、中東、亞洲及東歐等高成長市場深耕通路與在地服務能力，再選擇性拓展北美與歐洲大型企業客戶。

陳志鵬強調，隨著資料主權與資安法規趨嚴，企業將 AI 推論工作負載留在地端的需求明顯升溫，成為廣盛切入的新戰場，品牌業務以產品銷售的一次性收入、軟體訂閱的經常性收入與售後增值服務的高毛利收入形成循環，OEM 軟體授權則帶來高附加價值收益，望持續墊高獲利品質。

根據第三方評測媒體 StorageReview 測試顯示，廣盛產品的效能較同級國際品牌高出約 74%，相同延遲提供更高效能，客戶端已累積跨國標竿案例，包括布達佩斯智慧城市監控、韓國仁川國際機場關鍵基礎設施、印度 TATA Motors 智慧工廠、LG Energy Solution。

財務表現方面，廣盛 2025 年營收 3.85 億萬元，年增 22%；營業毛利 1.67 億元，毛利率 43%；稅後淨利 3,556 萬元，年增 22%，每股稅後盈餘 (EPS) 自 5.03 元提升至 5.27 元，顯示核心技術能力與全球布局已逐步轉化為營收動能。



電力交易服務延伸日澳！泓德小金雞星星電力預計第四季登錄興櫃 財經新報 115.08.25

泓德能源小金雞星星電力預計第四季登錄興櫃，總經理關婷怡表示，目前綠電掌握的交易量達 210 億度，並有 210 億度的儲備來源，未來將持續透過高毛利的電力交易與系統整合，穩固營收結構，並計畫 2028 年將電力交易版圖拓展至日本與澳洲市場。

星星電力將以 Power Bank 營運模式及 Star Trade 電力交易平台為核心，推進綠電購售 PPA、電力交易服務及 SI 整合服務三大業務引擎，預估 2027 年營收年增約 107%、2028 年再成長約 53%，2026 年至 2028 年營收年複合成長率約 78%。

星星電力董事長周仕昌表示，電力產業正從集中式供給走向去中心化，分散在各地的光電、儲能、工廠負載及充電樁，而星星電力將以 Power Bank 模式為基礎、Star Trade AI 為核心，串聯五大電力市場，並透過電力訂閱制為企業管理市場波動，作為下一階段成長的重要基礎。

周仕昌指出，星星電力自 2025 年以 Power Bank 模式推動營運轉型，整合多元電源、綠電售電、能源聚合及電力交易，並透過 Star Trade 以 AI 分析跨市場訊號與區域特性，支援電價預測、投標及調度決策，已將發電、合約、交易與調度串聯為完整的電力營運能力。

周仕昌分享，星星電力發展三大業務引擎，以「綠電購售 PPA」透過長期合約建立穩定電源池與客戶基礎；「SI 整合服務」結合表後儲能、能源管理系統 (EMS) 及系統建置，將企業端設備轉化為可聚合的電力資源；「電力交易服務」透過預測、投標、調度及避險服務，提高能源資產運用效益。

星星電力總經理關婷怡表示，藉由綠電購售累積規模與客戶，SI 整合帶來更多可調度資源，而電力交易將這些資源轉化為更高價值的收入，依目前規劃，至 2028 年綠電購售 PPA 仍將是星星電力最大營收來源，毛利率則以電力交易服務最高。

關婷怡指出，隨著台灣綠電需求日益攀升，電網的穩定性與電力調度能力成為市場核心考驗，未來電力市場的決勝關鍵在於「匹配能力」與「系統調度能力」，並明確定調自身為「國際電力交易營運商」，透過精準的表前儲能調度，積極布局未來的綠電現貨市場。

關婷怡說明，目前泓德能源與星星電力有著明確的專業分工，泓德能源專注於前端的開發、建置 (EPC) 及未來的 AIDC (人工智慧數據中心) 建置，而星星電力負責後端的電力交易與調度營運，電力來源不僅依賴泓德能源，並有 70% 的外購電力來自其他合作夥伴，形成穩定的「綠電水庫」。

台灣市場方面，關婷怡指出，星星電力預計至 2028 年可供應風光電量體超過 1.2GW，其中外購容量約 951MW，目前累計綠電合約電量已超過 210 億度，2025 年實際轉供電量年增逾一倍，累計取得超過 40 萬張再生能源憑證，客戶涵蓋半導體、AI 資料中心、金融、電信及高耗能製造業。

儲能與電力交易方面，關婷怡指出，星星電力目前已有 60MW 表前儲能投入營運，預計年底累計上線容量達 360MW，表後儲能則提供客戶自建、星星代操及「ETF 5050 表後儲能共享方案」，並透過虛擬電廠（VPP）聚合企業端用電彈性，預計 2026 年底累積逾 1GWh 電力交易能力。

海外市場方面，關婷怡指出，星星電力已將 Star Trade AI 導入旗下日本北海道 50MW Helios 儲能案場，支援 JEPX 批發市場及 EPRX 需給調整力市場的交易決策，泓德能源在日本長期脫碳電源拍賣（LTDA）累計取得約 560MW 容量，預計自 2028 年起陸續由星星電力提供營運服務。

關婷怡分享，星星電力與日本中部電力 Miraiz 推動儲能型電力保險合作，目標容量上看 300MW，而澳洲當地營運團隊已完成建置，預計 2027 年上線自有投標及優化模型，逐步承接集團約 730MW 電力交易服務。

關婷怡強調，星星電力預期台灣市場將跟進日本經驗，逐步發展出包含調頻、綠電容量及現貨交易的完整市場，並積極開發充電樁的創新應用，目前已展開綠電移轉的跨時間段概念驗證（POC），更結合時間電價機制，讓企業能將綠電導入員工差旅或公務車充電，藉此滿足 ESG 減碳需求。



《電週邊》宜鼎三廠年底動工拚2028完工 旗下安提啟動IPO計畫 富聯網 115.08.27

宜鼎(5289)周四舉行實體法說會，由董事長簡川勝主持。簡董事長指出，受惠於工控與邊緣 AI(Edge AI)市場需求強勁，記憶體供需吃緊，下半年至明年的 DRAM 與儲存產品價格「只會抬頭、不會低頭」；此外，因應訂單快速成長，宜鼎規畫中的第三座新廠將在今年底動工，三廠規模預估比一廠、二廠加起來更大，評估將於 2028 年完工投產，而旗下專注邊緣 AI 解決方案的子公司安提國際(Aetina)近期表現同樣可期，亦已啟動 IPO 掛牌規畫。

市場關切毛利率表現，簡川勝強調，宜鼎毛利成長並非來自低價庫存紅利，而是源於高附加價值的產品策略。宜鼎全面聚焦工控與 AI 領域，具備剛性需求與價格轉嫁能力，並透過整合硬體、軟體與邊緣生態系，建立技術護城河。在邊緣 AI 布局上，簡川勝表示，相較於雲端運算，涵蓋實體 AI(Physical AI)、人形機器人、智慧製造及醫療等邊緣應用場域更為廣大，而軟體正是系統快速整合與落地的致勝關鍵。

產能與財務方面，宜鼎指出，現有宜蘭二廠產能充裕，可全力滿足明、後年的營運成長需求，三廠則預計 2028 年加入生產行列；資本支出與營業費用率亦將隨營收規模同步維持穩定格局。



耐特將上市 拓展雙應用 經濟日報 115.08.31

晶圓載具及 BBU 材料供應商耐特 (8058) 股票上市案獲准，經台灣證券交易所審查通過，上市半導體材料業者將再添生力軍。據了解，極紫外光光罩盒龍頭家登是他的客戶，也因此間接打入台積電供應鏈。

耐特目前登錄興櫃，主攻 PEEK、PEI 等高性能塑膠複合材料，產品已切入半導體、備援電池模組(BBU) 等供應鏈，應用涵蓋半導體載具、封測等領域，並已打入先進製程載具供應鏈，後續將進一步布局「光罩盒、先進封裝」等高門檻應用。

耐特創立於 1988 年，實收資本額 6.88 億元，去年 7 月登錄興櫃，今年申請股票上市，上市案於 28 日經證交所審查通過。公司主要產品包括高溫材料、特種塑膠、高導熱塑膠、防延燒材料、環境友善材料及高性能複合材料等，應用範圍涵蓋汽機車、電子電機、開關連接器、機械設備、醫療器材等領域。

耐特表示，公司主攻高性能塑膠複合材料客製化開發、模具設計及加工工藝技術顧問服務，並從產品設計階段即與客戶協同開發，以確保材料特性與製程需求匹配，進而快速導入量產。隨著半導體及 AI 伺服器等高階應用需求增加，公司近年積極擴大高性能材料布局，2022 年完成台灣半導體材料產線建置，切入晶圓載具及 BBU 材料供應鏈，正式跨足高階複合材料市場。



致茂股東會擬討論現增 GDR 法人估籌資上看267億元 經濟日報 115.08.26

致茂 (2360) 25 日公告公司董事會決議召開 115 年第 1 次股東臨時會，股東臨時會召開日期：115/10/20，討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 GDR 案，法人今日分析，按照發行不超過 1360 萬股普通股，以昨日收盤價換算估計籌資最高為 267 億元有助於營運。

法人估計，該案估計約 3%的股份稀釋仍屬於可控，應該有助於加強和關鍵客戶的關係與營運長期需求。

致茂昨日公告說明，擬提請股東會授權董事會，現金增資發行普通股不超過 1,360 萬股額度內發行。員工認購股數或配發金額：依法保留發行股份總數 10%，其餘 90%擬依證券交易法第 28 條之 1 之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行，增資資金用途：擴充海外營運規模、海外購料需求。



聯電發18億美元海外轉換公司債買設備及廠務工程 中央通訊社 115.08.26

晶圓代工廠聯電董事會今天決議發行海外無擔保轉換公司債，總額以 18 億美元為上限，籌得資金將用於購置機器設備及廠務工程。聯電指出，海外無擔保轉換公司債每張債券面額暫定 20 萬美元，如超過 20 萬美元，則以 10 萬美元的整數倍數發行，發行期間為不超過 5 年之一定年限。

聯電表示，這次的海外無擔保轉換公司債將於中華民國境外依銷售地區當地法令規定及國際市場慣例，全數對外公開發行。為購置機器設備資金需求，聯電日前發行國內第二次無擔保轉換公司債，共 4 萬張，總額 40 億元，由宏遠證券承銷，預計 9 月 3 日於櫃檯買賣中心掛牌。

聯電董事會 7 月底通過分階段擴產計畫，以因應客戶持續成長的需求。聯電將擴建新加坡廠區無塵室產能，同步於台灣南科興建新廠，今年資本支出調升至 20 億美元。



盟立現增募資約11.73億元，擴充先進封裝及AI自動化產能 MoneyDJ 115.08.27

盟立(2464)積極擴大半導體先進封裝與 AI 自動化布局，並同步強化財務結構。公司公告辦理現金增資發行 850 萬股，每股發行價格 138 元，預計募集資金約 11.73 億元，資金將用於償還銀行借款及充實營運資金；另一方面，盟立今年整體產能規劃擴增 30%至 40%，其中半導體高端設備產能增加逾 30%，並同步擴充機器人、機器狗及關節模組供應鏈產能，持續搶攻 AI、先進封裝及智慧物流商機。

盟立今年上半年 EPS 0.66 元，較去年同期-0.59 元轉盈，今年以來營收呈現逐月成長，前 7 月累計營收 48.96 億元，年增 25.64%。盟立今(27)日股價攻上漲停，來到 211 元。

盟立為智慧自動化設備系統廠，產品涵蓋半導體設備、智能自動化、光電面板自動化及數位科技等領域，其中近年營運重心明顯朝半導體移動。盟立 2025 年半導體設備系統占產品應用比重已達 57%，法人預估，今年隨相關案件持續推進，半導體設備系統合併營收占比可望進一步突破 60%。

先進封裝為盟立今年主要成長動能之一，公司布局 OHT 空中搬運系統、Stocker 自動倉儲，以及 300mm 晶圓、ABF 載板、FOPLP 與 Panel Handling 等解決方案，可因應 CoWoS、CoPoS、CoWoP 等先進封裝製程所需的多尺寸載具、高潔淨度及高彈性搬運需求。東南亞市場方面，馬來西亞、新加坡及泰國半導體客戶案件持續推進，也成為海外成長的重要來源。

因應後續訂單需求，盟立今年啟動較大幅度擴產，整體產能目標增加 30%至 40%，半導體高端設備產能擴增超過 30%；同時透過全球生產基地與供應鏈布局，提高對客戶需求的反應速度。

除半導體外，AI 機器人與機器狗也是盟立另一項新事業布局。盟立依半導體、物流及製造業客戶實際場域需求，制定 AI 人形機器人及機器狗的規格與功能，並投入本體開發；法人指出，相關本體開發已完成，規劃今年開始出貨。配合新事業推進，盟立機器人、機器狗及關節模組供應鏈規劃建立年產 500 台產能。

盟立智慧自動化物流業務也逐步回溫，法人指出，隨美國關稅政策影響逐漸明朗，客戶陸續確立投資設廠計畫，先前因不確定因素延後的自動化系統案件開始恢復，來自北美、歐洲及東南亞的需求逐步確定；盟立也已承接 EMS 客戶北美廠自動化系統訂單，預計今年出貨，為營運增添動能。



安成生技(6610)4.5億元現增到位！核心新藥AC-203迎關鍵里程碑 東森財經新聞 115.08.28

安成生技(6610)營運迎來資金與臨床雙重重要里程碑！公司 27 日宣布 115 年度現金增資案順利完成，以每股 25 元發行普通股 18,000,000 股，成功募集 4.5 億元且資金已全數到位，將用於充實營運資金及推進新藥開發。安成生技核心新藥 AC-203 全球第二 / 三期樞紐性臨床試驗預計於 2026 年第四季公布主要療效結果，隨後將加速啟動全球法規申請與商業化布局。

安成生技本次現增順利完成，不僅大幅強化公司財務結構與營運資源，更為核心產品 AC-203 的最後臨床衝刺、全球法規申請及後續商業化準備提供堅實後盾。

AC-203 主要用於治療罕見疾病「單純型遺傳性表皮分解性水皰症」(EBS)，其全球第二 / 三期樞紐性臨床試驗 EBSHield Study 目前已順利完成 81 位受試者收案，並完成所有主要療效指標評估，試驗進入最後階段，第四季公布主要療效結果將成為公司最重要的法規催化劑。

在臨床數據揭曉前夕，安成生技亦同步展開全球商務開發與授權合作布局，持續依據產品開發進度及市場需求，積極推動全球授權、區域合作及策略聯盟等多元商業模式，以擴大新藥價值並加速打入國際市場。董事長吳怡君指出，本次現增順利完成讓公司能以更穩健的財務基礎，迎接 AC-203 接續的重要臨床與法規里程碑，創造股東長期利益。

除了主力新藥 AC-203 進入解盲倒數外，安成生技產品管線亦包含 NORA520 與 AC-1101，全面涵蓋罕見疾病、發炎性皮膚疾病及中樞神經用藥等潛力領域。法人分析，隨著 4.5 億元資金挹注到位，安成生技具備充足糧草加速推動 AC-203 解盲後的全球商業化與授權談判，配合多軌產品管線並進，中長線研發價值與國際市場能見度將顯著提升。



聯發科完成39億美元海外可轉債訂價 輝達、Alphabet 都出手認購 經濟日報 115.08.31

繼聯發科 (2454) 董事會於今年 7 月 31 日通過彈性融資預算案，聯發科技今日宣布完成總額 39 億美金，超過 1,200 億台幣的海外可轉債訂價，為台灣資本市場至今金額最高的海外可轉債發行。此次海外募資案吸引來自 AI 基礎建設的長期重要合作夥伴包括 NVIDIA 和 Alphabet，以及著名國際投資人的熱烈參與及認購，展現對聯發科技由 AI ASIC 晶片擴展至機櫃級運算系統與平台 (full scale systems and platform) 策略布局的信心。

聯發科表示，憑藉聯發科技在 AI 基礎建設、邊緣 AI 運算、旗艦行動平台、連結技術、物聯網，以及實體 AI 世代下軟體定義汽車等領域的領先地位，聯發科技將與客戶及合作夥伴共同掌握 AI 從邊緣到雲端全面擴展所帶來的長期成長機會。

聯發科也與 NVIDIA 宣布將深化從邊緣 AI 到雲端 AI 的長期合作夥伴關係，打造跨世代的 AI 基礎建設、邊緣 AI 運算與實體 AI 世代下的車用產品。在這更緊密的合作下，除了既有的 AI ASIC 晶片之外，聯發科技將採用 NVIDIA 最新 NVLink Fusion 平台，協助客戶快速將客製化 XPU 帶入以 NVIDIA NVLink 連結的機櫃級 AI 工廠。

聯發科將以 NVIDIA NVLink Fusion 台為設計基礎，為客戶開發客製化 AI 加速器。NVLink Fusion 平台提供預先建置(prebuilt)、預先認證(prequalified)與系統級預先驗證(system-prevalidated)的平台，加速客戶從晶片、先進封裝到機櫃級系統的開發進程，客戶無須從頭開發與驗證客製化 XPU 周邊的各項系統元件，更能將資源集中在打造平台核心優勢的差異化運算能力上。



Grab擬併foodpanda 外送團體反對 中國時報 115.08.19

Grab 擬併購 foodpanda 台灣業務，外送等相關團體 18 日赴公平會表達反對意見，呼籲應否決該案；全國總工會則說，外送產業併購案目前仍由公平交易委員會依法審查，各界應尊重專業機制，避免透過媒體操作形成片面輿論，影響審查結果。公平會表示，該起結合申報案目前仍在依法審查中，對於最終審查結果並無預設任何特定立場。

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，Uber 至今仍持有 Grab 約 13% 股份，他要求 Grab 應具體說明，究竟有何實質機制能確保這 13% 的利益關係不會削弱雙方在台灣市場的競爭誘因？若提不出防範機制，資方所謂的「競爭」便淪為毫無根據的空頭支票，代表工會嚴正要求公平會，必須堅定守護市場機制，直接駁回此項併購案。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾也說，資本家的承諾往往只是應付審查的緩兵之計，呼籲公平會堅守反壟斷法初衷，在疑慮未徹底釐清前，應拿出骨氣直接駁回此併購案，替台灣基層勞工守住最後的生存底線。

惠理 金融法律事務所合署律師林佳儒指出，借鑑新加坡與菲律賓經驗，針對大型外送平台併購絕不宜採取「附條件同意」的妥協作法，否則事後的違規裁罰對企業而言往往只會淪為營運成本，呼籲公平會基於捍衛數位主權立場駁回本案，並提醒各界在審查結果出爐前切勿帶動風向，應尊重獨立機關的專業判斷。

全國總工會則說，政府應依法完成專業審查，各界也應回歸理性對話與正式協商機制，共同為台灣外送產業尋求最適合的發展方向。

公平會指出，依據《公平交易法》規定，事業結合申報的審查結果包含禁止結合、不禁止結合，以及附負擔或條件不禁止結合等 3 種類型。公平會審查每一件案件時，均會以整體經濟利益是否大於限制競爭之不利益為核心考量，並交由委員會議作成決議，Grab 案亦不例外。

公平會強調，審查過程將充分審酌各界意見，並依市場調查所獲資訊與證據進行完整競爭評估，在委員會議正式決議前，絕無預設立場。全案預期在 10 月底前有結果。



財經七案 下會期再戰 經濟日報 115.08.25

立法院即將休會，盤點行政院本會期所列財經優先法案，還有八大法案尚未三讀。其中企業併購法本周有望三讀，其餘還包括都更條例、危老條例、租賃專法、投信投顧法、促進資料創新利用發展條例、海關進口稅則、財劃法等七案，要留待下會期再戰。

企業併購法預計本周內三讀。修法盼通過以股份轉換方式成立、且符合一定條件，被收購公司股東所產生的證券交易所得，可選擇免計入當年度基本所得額（最低稅負）課稅，並於實際轉讓時再課徵。國發會評估，修法通過後能達到五年成立 15 家產業控股公司目標。

其餘法令方面，「都更條例」修法增訂全案管理機構法定定位，明確其統籌整合、財務協助及工程管理職能，協助所有權人以多元型態自主推動都市更新。

「危老條例」是因應落日期限，提出修法讓危老重建常態化，加速老屋重建，另也將擴大租稅優惠。

「租賃專法」則主要保障房客申請租金補貼及遷入戶籍權益，以及訂定「租霸下車條款」，不過原先規劃納入「保障三年租期」、「限制續約租金漲幅」等，因擔心動搖房東出租意願，對租屋市場帶來副作用，這兩項修法已踩煞車。

「投信投顧法」修法主要是開放不動產投資信託（REITs）改採基金架構發行。



台灣連鎖餐飲含金量高 外資狩獵目標 LTN經濟通 115.08.31

今年 8 月初外媒揭露，美國私募股權公司貝恩資本 (Bain Capital) 決定收購台灣手搖飲連鎖品牌貢茶 (Gong Cha)。計劃以超過 6.35 億美元 (約新台幣 202 億元) 的價格從美國私募股權公司 TA Associates 及其他股東手中收購貢茶的股份。

貝恩資本和 TA Associates 已達成最終協議，預計在年底前完成交易。雖然多家投資基金和連鎖餐廳都提交了收購方案，但貝恩公司獲得了優先購買權。

報導指，貝恩資本在投資連鎖餐廳方面經驗豐富，曾投資日本達美樂披薩。貢茶計畫借助貝恩資本的專業知識和數位行銷能力，拓展其在日本和南韓的門市網路。這 2 個國家是貢茶擁有強大客戶群的地區，該公司也將加快在美國的門市擴張步伐。

接著《彭博》指出，在 8 月初貝恩資本從 TA Associates 手中收購貢茶後，瑞士私募股權巨頭合眾集團 (Partners Group) 將退出其對貢茶的私人信貸投資。其已達成協議，將獲得全部還款。根據《彭博》看到的一份文件，合眾集團在 2019 年提供了一筆超過 2 億美元的融資方案，以支持 TA Associates 收購貢茶，同時也取得了貢茶的少數股權。

台灣手搖飲市場競爭激烈，從珍珠奶茶到各式茶飲品牌，街頭巷尾從不缺新面孔，但真正受到國際私募資本青睞、甚至一再成為併購標的的，卻是發源於高雄的貢茶，其在台灣不到 10 家門市。貢茶究竟有何特殊魅力，讓國際資本一再押注？

全球 2000 多家門市

貢茶於 2006 年在台灣高雄創立，原始創辦人為吳振華，當時憑藉「奶蓋茶」突圍，如今已經走出一條與多數台灣手搖飲業者截然不同的道路。它以珍珠奶茶而聞名全球，目前在包括亞洲、美國和歐洲在內約 30 個國家，經營 2000 多家門市。

貢茶的股權過去曾數度易手，從區域小品牌，變身成為國際連鎖企業。「關鍵轉機」出現在 2011 年，當時澳洲籍銀行家 Martin Berry 偶然在看見新加坡一間貢茶門市大排長龍，並意識到它更大的潛力，在隔年買下南韓特許經營權，於南韓做大擴張至逾 300 間門市。

2014 年，日本私募股權基金 Unison 資本公司 (後更名 UCK Partners) 收購了貢茶的南韓業務，並主導品牌的全球擴張，並利用其在日本的銷售網路進一步拓展日本市場，推動管理、運營和加盟體系的專業化；到了 2017 年，南韓貢茶再「反向收購」買下台灣母公司約 70% 股權。

2019 年，美國私募股權公司 TA Associates 再以合計砸逾 3 億美元，除了向日韓團隊買下股權，也以新台幣 11.6 億元買了台灣創辦人手中最後 30% 股權，貢茶「100% 成為外資企業」，總部遷往英國。如今，再被貝恩資本收購。

私募基金看中的是市場規模

台灣手搖飲品牌這麼多，然而，當資本市場開始評估這些品牌的價值時，看的並不只是誰的飲料最好喝、誰在台灣最有知名度，而是另一個更現實的問題，「這個品牌能不能走出台灣，並且在全球市場持續複製」。

為什麼受到 3 家私募基金青睞的會是貢茶？答案首先在於「市場規模」。如果一家手搖飲品牌主要依賴台灣市場，即使擁有極高知名度與大量門市，成長仍會受到台灣人口與消費市場規模限制。相較之下，貢茶的營運模式已經走向全球。對投資人而言，貢茶的市場不再只是台灣，而是日本、南韓、美國、英國以及其他仍有機會展店的國家。加盟制度則是貢茶另一項重要資產。對私募基金而言，這種模式具有較高的資本效率。只要品牌具備足夠吸引力，加上產品與門市流程可以標準化，就能透過加盟商將品牌快速複製到不同市場。

更重要的是，私募基金投資企業時，「看的通常不只是當下獲利，而是未來的『退出價值』」，買進、養大並且能快速脫手。私募基金買下一個品牌後，會希望透過展店、提高營運效率、拓展市場等方式提升企業價值，幾年後再出售給下一個投資人或策略買家。

此外，手搖飲本身也具備容易標準化的特性。從茶葉、糖度、配方到製作流程與門市設備，都可以建立相對明確的標準。這使得品牌更容易透過加盟制度，在不同國家維持相近的產品與服務品質。使手搖飲在餐飲產業中，成為少數具備私募基金所看重特質的市場。

並且，貢茶創辦人早在 2017 年便已退出經營，使品牌後續發展已逐步轉向專業經理人主導的管理模式，這對私募基金而言也是一項重要優勢。

菲律賓快樂蜂集團 收購迷客夏及雙月

近年台灣餐飲市場受到國際資本關注，手搖飲、餐飲連鎖品牌陸續成為投資人尋找成長機會的標的。2021 年 11 月，菲律賓速食龍頭快樂蜂集團 (Jollibee) 以約 3.6 億元台幣，收購迷客夏 51% 股權，成為最大股東。2025 年 1 月，快樂蜂再透過旗下子公司「迷客夏國際股份有限公司」，斥資 1 億元收購雙月食品社 70% 股權。

相較之下，快樂蜂布局迷客夏、雙月等台灣餐飲品牌，更偏向大型餐飲集團的策略性投資。兩者最大的差異，在於資本扮演的角色不同。私募基金投資貢茶，重點在於透過管理改善、品牌擴張與國際化提高企業價值，並尋找適當的退出時機；大型餐飲集團則可以更長期地持有品牌，利用自身資源將台灣成功模式複製到海外，並藉此擴大其國際餐飲版圖。

對貝恩資本而言，接手貢茶或許不是在購買一個已經完成的成功故事，而是在押注下一個成長階段。貢茶如今已經擁有接近 2200 家門市，如果單純依靠現有門市數量，未必足以支撐一家大型私募基金長期追求的投資報酬。因此，其真正看中的，很可能是貢茶在既有市場之外仍然存在的大量展店機會。貢茶方面就表示，將同時加快美國市場的展店速度。美國市場尤其具有象徵意義。珍珠奶茶已經逐漸從亞洲特色飲品走進美國主要城市，但整體茶飲市場仍然存在相當大的發展空間。



鴻海、英飛凌點出台廠投資歐盟新機會：從封裝一路攻AI資料中心**經濟日報 115.09.01**

歐洲晶片法案 2.0 將政策觸角從半導體供給端進一步延伸至需求與 AI 基礎建設，也替台灣供應鏈打開新機會。鴻海、英飛凌及歐洲地方政府代表今日在投資歐盟論壇指出，台灣赴歐投資的機會已不只是跟隨晶圓廠設廠，而是從先進封裝、零組件、模組、AI 伺服器一路延伸至 AI 資料中心及 AI 工廠；但台廠也必須重新思考區域供應鏈，依各國人才、材料與既有生態系進行分工，而非把台灣供應鏈原封不動搬到歐洲。

鴻海董事長辦公室 AI 與量子運算負責人趙元瀚對於投資歐盟的觀點，認同台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清提到先看「市場需求」，但當晶圓在歐洲製造後，接下來就會衍生封裝、模組、次系統乃至最終產品應在哪裡生產的機會。

他提到，鴻海正重新思考區域供應鏈的樣貌，並已與法國企業合作發展先進封裝。鴻海今年 6 月宣布與接連器廠 Radiall、軍巨器廠泰雷斯 (Thales) 成立 Tessalia Technology，投入半導體封測，規畫 2033 年前每年生產超過 5,000 萬顆系統級封裝 (SiP) 元件。鴻海同時已在捷克及法國推進 AI 伺服器製造布局。

趙元瀚表示，未來可以從晶圓、晶片一路延伸至模組、次系統及完整系統，把歐洲甚至 EMEA (歐洲、中東及非洲) 視為建立供應鏈韌性及在地製造能力的更大區域。

他強調，「不是台積電或鴻海任何一家公司就可以做所有事情」，台灣還有大量具競爭力的中小企業，因此如何伴隨大型企業布局，把台灣生態系一起帶進歐洲將是下一步。隨歐洲推進 AI 工廠、AI 超級工廠，台灣企業也有機會共同參與 AI 基礎設施建設。

不過，趙元瀚認為，台廠不能只是複製既有供應鏈，而應觀察不同歐洲城市、國家擁有的人才、材料及既有產業聚落，再決定哪些環節適合上游、哪些適合接近下游市場。鴻海希望發揮台灣「規模化」能力，把歐洲優秀的設計以更好的成本結構、更快的上市速度推向量產。

英飛凌副總裁暨台灣區董事總經理陳志豪則指出，歐洲擁有強大的半導體研究與技術，台灣則強在製造、系統整合及快速規模量產，雙方具高度互補性。尤其歐洲擴大 AI 資料中心投資，台灣在伺服器及系統整合累積的能力，可望成為下游應用的重要機會。

他認為，台歐合作不應只看到先進奈米製程，AI 資料中心龐大的「Energy hunger (能源需求)」也將推升功率半導體、能源效率及電力基礎設施需求，從矽、碳化矽 (SiC) 到氮化鎵 (GaN)，以及資料安全、能源韌性，都有合作空間。

歐洲地方政府也積極向台灣招手。歐洲半導體區聯盟董事會成員 Toon Van Dijk 表示，此行來台目的就是尋找台灣企業合作及投資機會。當地正以 Almere 高科技園區建立半導體生態系，ASM International 將進駐並布局研發及培訓設施。歐洲晶片法案 2.0 若能進一步縮短許可程序、降低行政障礙並擴大國際合作，將提高台灣企業赴歐投資意願。



AI 需求強勁！第2季製造業產值逾6.8兆元、年增27.1% 連10季正成長 經濟日報 115.08.19

經濟部 19 日發布今年第 2 季製造業產值統計，受惠 AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，帶動資訊電子產業生產動能，加以部分傳統產業因資訊電子產業需求增加，以及上年同季比較基數較低，2026 年第 2 季製造業產值 6 兆 8,657 億元，較上年同季增加 27.10%，連續 10 季正成長。

資訊電子產業方面，經濟部統計指出，電子零組件業產值較上年同季增加 33.70%，其中積體電路業受惠高效能運算與 AI 應用需求續呈強勁，年增 37.12%；面板及其組件業因 TFT-LCD 面板需求疲弱，產值年減 8.43%；電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務及相關基礎設施需求持續暢旺，加以半導體設備投資動能擴增，年增 73.29%。

傳統產業方面，經濟部指出，受惠半導體擴產與電子零組件材料需求增溫帶動，加以上年同季部分產線歲修之低基期效應，機械設備業產值年增 11.85%、基本金屬業產值年增 10.22%、化學材料及肥料業產值年增 9.09%；汽車及其零件業產值年減 0.76%，主因客戶需求保守而調節減產，惟部分車款受惠貨物稅減徵及客運車輛電動化政策激勵而增產，抵銷部分減幅。

經濟部說明，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2026 年第 2 季製造業生產指數 136.49，較上年同季增加 17.44%，連續 10 季正成長。

展望未來，經濟部表示，地緣政治及國際貿易爭端持續影響全球經濟成長動能，惟隨 AI 應用需求持續擴增、全球雲端服務大廠積極投資，以及各國加速布建 AI 基礎設施，均有助推升我國半導體先進製程、高階封裝與伺服器供應鏈生產動能，支撐我國製造業生產維持成長態勢。



畢業生尋職！7月失業率升至3.39%、仍創26年同月最低 自由財經 115.08.24

主計總處今公布 7 月失業率 3.39%、續創 26 年同月最低，但較 6 月上升 0.05 個百分點，連續 2 個月走升，主因應屆畢業生投入尋職；經季節調整後，7 月失業率為 3.33%、與上月持平。主計總處表示，由於畢業生陸續投入尋職，預料 8 月失業率續回升，但 9 月應會回降，目前勞動市場仍穩定。

根據主計總處調查，7 月就業人數 1165.1 萬人，月增 1.4 萬人、年增 1.3 萬人；1 至 7 月就業人數平均 1164.1 萬人、年增 2.4 萬人。7 月失業人數則為 40.9 萬人、月增 7 千人，其中初次尋職失業增加 4 千人，主因應屆畢業生投入尋職行列，因季節性或臨時性工作結束而失業者也增 3 千人。

按年齡層觀察，15 至 24 歲者失業率 11.71%最高，多為初次尋職，處於職場調適階段，且適逢畢業季，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25 至 29 歲失業率為 5.82%，30 至 34 歲失業率為 3.29%。

勞動力低度運用方面，7 月 4 週失業人數 41.6 萬人，月增 9 千人、年增 2 千人。工時不足就業人數 12.2 萬人，月增 1 千人、年增 5 千人。潛在勞動力人數則為 12.8 萬人，月增 3 千人、年減 8 千人。



伺服器、記憶體出口暢旺！7月批發業營業額1.75兆元 年增56.4%雙創高 經濟日報 115.08.25

經濟部 25 日發布 7 月零售業營業額 4,183 億元、餐飲業營業額 887 億元，皆創歷年同月新高，分別年增 7.7%及 2.5%，皆呈連續 6 個月正成長。另，受惠於 AI 需求，批發業營業額達 1.75 兆元，創歷年單月新高，年增 56.4%，創歷年單月最高增幅，呈連續 18 個月正成長，表現亮眼。

經濟部統計處長陳玉芳表示，7 月批發業營業額約一半出口、一半內需，批發業營業額達 1 兆 7,573 億元；其中機械器具批發業受惠 AI 需求，推升伺服器、記憶體及相關電子零組件出口暢旺，營業額達 1 兆 1,287 億元，創歷年單月新高，年增 103.4%則創歷年單月次高紀錄。

陳玉芳表示，今年前 7 月批發業營業額達 10 兆 7,905 億元，隨著 AI 需求持續暢旺，預估今年 9 月底批發業營業額有機會超過去年全年營業額 14 兆元。

內需方面，陳玉芳表示，7 月零售業和餐飲業營業額年增率表現，不如預期，主因是 7 月颱風因素，惟影響天數及範圍難以量化。她說，颱風因素影響最明顯是餐館，另超市量販則因民眾囤貨則增加消費，飲料店則有高溫刺激需求。

她表示，7 月零售餐飲營業額仍創歷年同月新高；累計今年前七月零售業營業額 2 兆 8,810 億元、餐飲業為 6,422 億元，皆創歷年同期新高，整體表現並不差。

展望未來，陳玉芳說，批發業受惠 AI 等科技應用快速擴展，挹注相關供應鏈出貨動能，預期營業額年增率持續強勁；零售業則受惠父親節、情人節送禮及中元普渡採購需求，加以百貨新商場之集客效應，營業額可望續呈增勢；餐飲業因暑假出遊外食及節慶聚餐商機挹注，加以夏日高溫帶動冰飲品銷售，營業額可望延續成長態勢。



加強與台AI鏈合作！傳晶片材料廠味之素、大金 擴大台灣營運 經濟日報 115.09.01

日媒報導，消息人士透露，味之素正在台灣設立研發中心。該公司是「味之素積層膜」(ABF) 的獨家供應商，ABF 是基板的關鍵原料，基板能用於 AI 運算與資料中心晶片。台灣載板業者欣興、景碩、南亞電路板、臻鼎，均使用 ABF。

另一晶片製造材料公司大金工業，也擬於台灣成立科技應用中心，深化與台灣半導體生態鏈的合作，反映晶片相關需求成為該公司的新成長引擎。大金的氟化學品與氟聚合物，在新冠疫情時，曾是晶片短缺的主要瓶頸。

據國際半導體產業協會 (SEMI) 最新預測，台灣過去幾年都是世界最大的半導體材料市場，促使愈來愈多全球晶片材料廠在台拓展業務。

晶片業高層表示，先前知名材料廠不覺得需要在初期階段，就與客戶密切合作，只賣原料就好。但 AI 熱潮改變了這種局面，材料廠發現需要更了解相關應用與下游市場需求，不希望錯失 AI 帶來的巨大商機。

